

レーザー協会 第204回研究会

「レーザーによる表面改質と平滑化」

開催日時: 令和8年3月9日(月) 13:30~17:00

会場: 慶應義塾大学 日吉キャンパス 来往舎 2階 中会議室

(〒223-8521神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1)

最寄り駅: 東急(東横線、目黒線、新横浜線) / 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅)

(<https://www.keio.ac.jp/ja/maps/hiyoshi.html>)

開催形式: 対面形式

研究会主旨: レーザによる表面改質と平滑化は、製品の信頼性向上や高機能化、低コスト化にも寄与するため、産業における重要性が高まっている。本研究会では「レーザーによる表面改質と平滑化」と題し、計4件の講演を予定しています。レーザーによる表面材質・応力状態の制御や表面粗さの低減に関する最新技術を紹介頂きます。万障お繰り合わせの上、ご出席賜りますようお願い申し上げます。

13:30~13:35 **開会挨拶**

レーザー協会会長

13:35~14:20 **講演1**

「レーザーキャビテーションピーニング」

東北大学 祖山 均氏

14:20~15:05 **講演2**

「レーザーピーニングの効果の紹介」

新東工業株式会社 矢野敬博氏

15:05~15:20

休憩

15:20~16:05 **講演3**

「水溶液を活用したレーザー誘起湿式表面改質法による金属材料への機能性付与」

三条市立大学 江面篤志氏

16:05~16:50 **講演4**

「レーザーによる表面平滑化およびその応用事例」

慶應義塾大学 閻 紀旺氏

16:50~17:00 **閉会挨拶**

レーザー協会副会長

【参加費】 会員: 無料 非会員: 7,000 円(銀行振り込み)

【申込先】 申込みフォーム(QRコード, <https://forms.gle/KgHV98jkfst3Nhc8>)より申し込み下さい。フォームがアクセスできない場合はレーザー協会事務局にメールでお申し込みください。

【参加申込・振込〆切】 令和8年3月2日(月)

【問合先】 レーザ協会事務局 laser@mech.saitama-u.ac.jp

